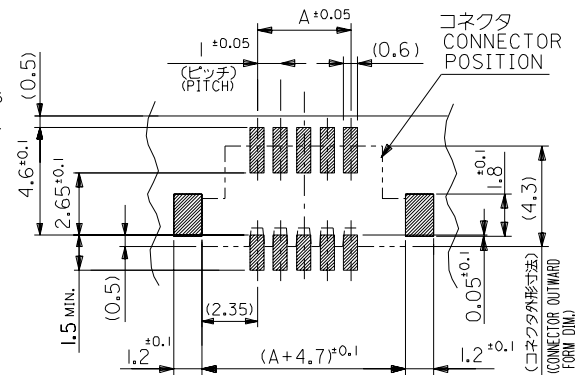
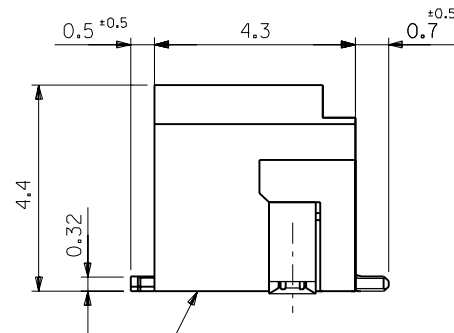
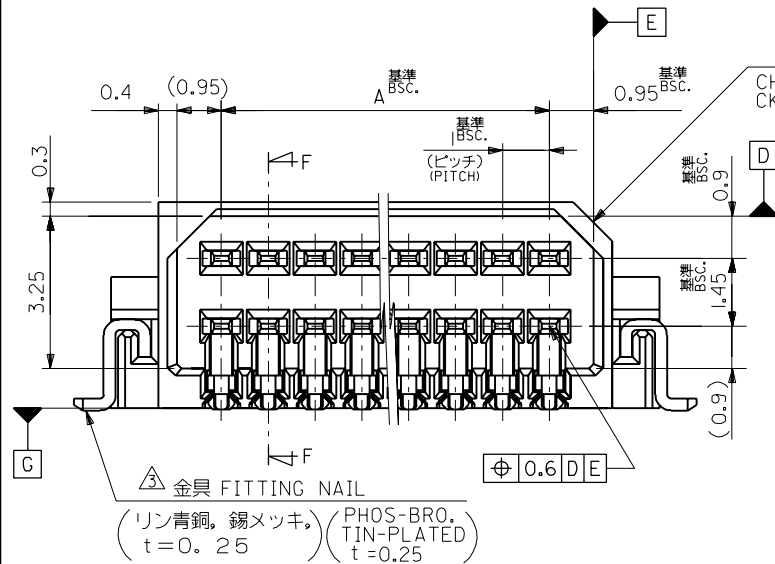
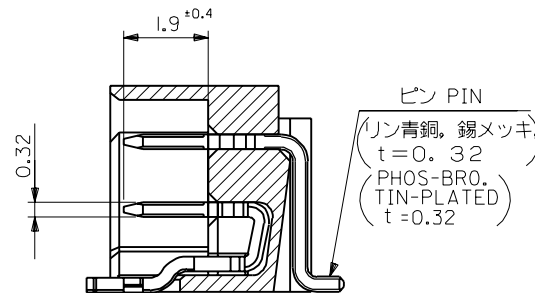
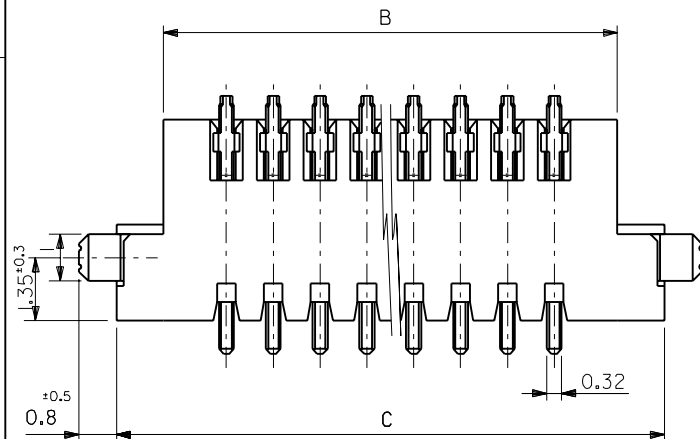




パターン参考寸法 (マウント面)
RECOMMENDED DIM. FOR P.C. BOARD
MOUNTING PATTERN (REF.)



SECT. F-F

注記 NOTES.

- 嵌合相手: 52365-***10, 52365-***20
MATES WITH: 52365-***10, 52365-***20
- ハウジングの底面 [G] からの金具及びターミナル半田付面のズレ量は
上方0.1MAX. 下方0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL TIP AND FITTING NAIL FROM [G]
: UPPER DIRECTION 0.1mmMAX.
: LOWER DIRECTION 0.15mmMAX.

△ パターンハワリ止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 30 未満 OVER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	— # —
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —
DRAWN BY 92/8/3 S. SAHARA	CHK'D BY 92/08/06 M. SAKABOMORO
APP'D BY 92/08/03 M. KAWAMURA	尺 度 SCALE — # —

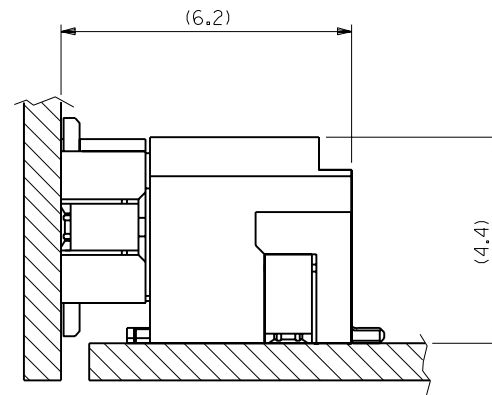
MOLEX JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
I.O B TO B CONN.
WAFER ASS'Y R/A SMT.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-53268-***20 A

A



角度	ANGLE
30 以上	OVER
10 以上 30 未滿	OVER UNDER
10 未滿	UNDER
一般公差	
GENERAL TOLERANCES	

				材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	
				SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE		I.O B TO B CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT.	
				DRAWN BY '92/8/3 S.AIHARA		'92/08/05 MSUKUDOMORO	
				APP'D BY '92/08/03 MUKUJOSHIMA		尺度 SCALE	
記号 LTR		表裏内容 REVISION RECORD		DR. CHK. 日付 DATE		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) SD-53268-**-20	
A		再作図 REDRAWN (J20684)		S.A. '92/8/3		REV A	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

53268B.S05 A

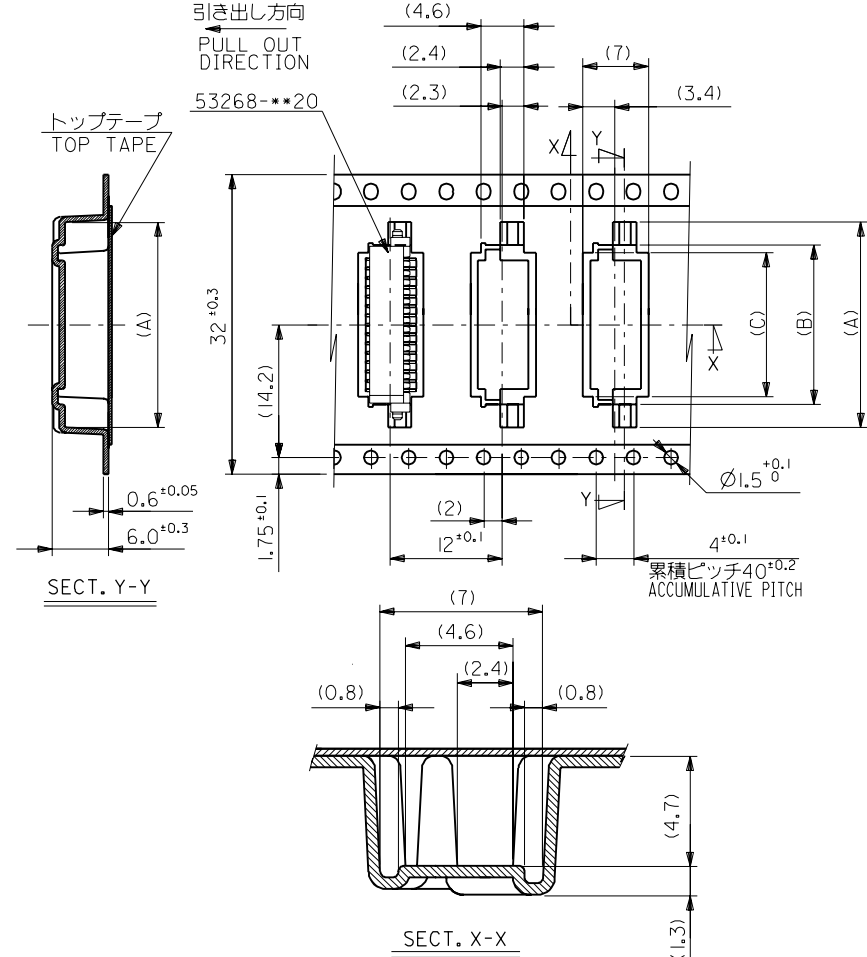
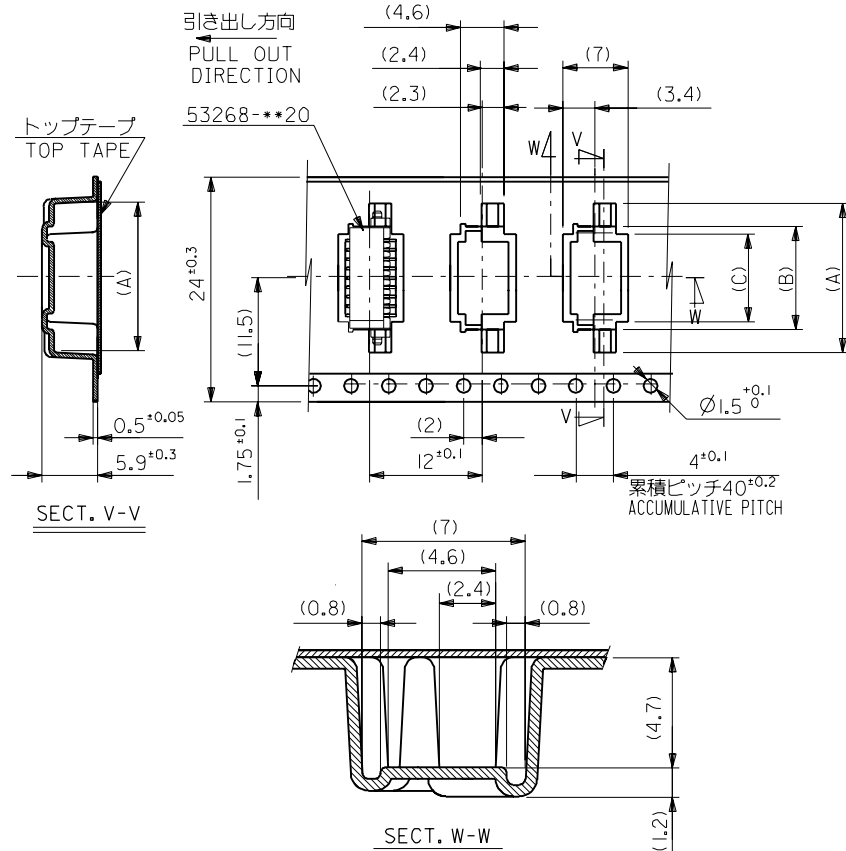
1

MXJ-8

ENG. NO.
SD-53268-***91

EDP. NO.

※MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



32	33.5	15.15	17	21.9	53268-3091	30
		14.15	16	20.9	53268-2891	28
		13.15	15	19.9	53268-2691	26
		12.15	14	18.9	53268-2491	24
24	25.5	11.1	13	17.9	53268-2291	22
		10.1	12	16.9	53268-2091	20
		9.1	11	15.9	53268-1891	18
		8.1	10	14.9	53268-1691	16
		7.1	9	13.9	53268-1491	14
		6.1	8	12.9	53268-1291	12
		5.1	7	11.9	53268-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度	ANGLE
30°以上	OVER
10°以上 30°未満	OVER 30 UNDER
10°未満	UNDER
一般公差	GENERAL TOLERANCES

材料 MATERIAL		参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
仕上り FINISH		---	EDP. NO. ---
適用電線範囲 WIRE RANGE		---	ENG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV D
被覆外径 INS. RANGE		---	SD-53268-***91
DRAWN BY '90/5/8 T.HARUYAMA		CHK'D BY '00/12/6 T.ITO	TITLE 名称 I/O B+B Conn Wafer Assy
APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE ---	RA SMT Embstp Pkg
REVISION RECORD			
記号 LTR	変更内容 REVISION	DR. CHK.	日付 DATE
D	変更 REVISED (JC2001-0421)	---	'00/12/6
C	変更 REVISED (J30601)	---	'93/6/22
B	変更 REVISED (J20879)	---	'92/9/26
A	変更 REVISED (J20684)	---	'92/8/3
O	新規/改訂 PROPOSED (J00464)	---	'90/5/8

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8